

崇达技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（线上业绩交流会）
参与单位名称	重阳战略、中信资管、中信里昂、汇添富基金、易方达基金、前海开源、中信银行、财通证券资管、招商证券、申万宏源证券、睿郡资产、万泰华瑞、大成基金、平安资产、太平资产、中信保诚资产、友邦人寿、招商信诺资产、真科基金江、创富兆业、淳阳私募、中信证券。 （注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况）
时间	2025 年 11 月 13 日
地点	中信证券策略会所在地
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：朱琼华
投资者关系活动主要内容介绍	主要问答： 1. 公司主要经营情况说明。 2025 年前三季度，公司实现收入 55.93 亿元，同比增长 20.27%；公司实现归母净利润 3.14 亿元，同比增长 19.58%；其中，2025 年第三季度，公司实现归母净利润 0.92 亿元，同比增长 252.87%，收入和净利润整体保持着良好的增长态势。 2. 公司后续如何实施有效举措来改善公司盈利能力，推动公司持续发展？ 答:为改善公司产品毛利率，公司结合自身业绩情况、积极应对市场变化，正采取一系列有效措施： （1）深耕高价值客户和订单，优化销售结构：公司加强亏损订单的管理，淘汰亏损订单，降低低利率订单比例，优化客户结构，与重点客户加强新产品联合研发，积极培育高附加值订单。同时针对工控、服务器、汽车电子等重点应用领域，梳理出全球范围

内具备行业引领地位、技术创新能力强且对PCB产品需求规模大、质量要求高的企业作为重点目标客户，通过定制化的产品解决方案与专业的技术支持，积极寻求与它们建立长期稳定的合作关系。

(2) 强化团队，提升销售专业服务能力：扩充并优化海外销售团队，选拔和培养一批具备丰富行业经验、精通国际商务规则、熟悉海外市场环境且具备良好沟通协调能力 的专业销售人才。同时，建立科学合理的绩效考核与激励机制，将高价值客户开发、高 价值订单获取以及客户满意度提升等指标纳入销售人员的绩效考核体系，充分调动销售 团队的工作积极性与创造性，确保销售工作的高效开展。

(3) 加强成本管理：深入推进工段成本管理标准化工作，降低单位产品成本。通过 各项降本增效措施，保持公司在成本方面的综合竞争优势，提高公司盈利能力。

(4) 协同保障，提升订单交付与客户服务水平：加强内部生产、计划、技术、品保 等部门与销售团队的沟通协作，优化生产计划与调度管理，合理安排产能，确保高价值 订单能够按时、高质量交付。

(5) 创新驱动，打造契合高价值客户需求的产品体系：针对高价值客户对PCB产品 轻薄化、小型化、集成化以及高速、高频、高可靠性等方面的严苛要求，加快新技术、 新工艺的研发与应用进程，尤其在高频高速高层板、高阶HDI板、IC载板等高端产品方面 加大投入，推动高端PCB产品占比持续提升，提高产品附加值。

(6) 扩充产能：加快产能扩充步伐，以适应未来市场发展需求。有序推进大连厂、 珠海一厂、珠海二厂的产能提升，加快泰国工厂的建设速度，加速高效产能释放，为实 现销售增长奠定坚实基础。

3、在原材料成本上涨的情况下，公司采取了哪些措施来缓解成本压力？

公司所涉及的主要原材料涵盖覆铜板、铜球、铜箔、半固化片以及氰化金钾等品类， 鉴于其价格与铜、石油及黄金等大宗商品价格存在紧密联动关系，自 2024 年 6 月份以来， 覆铜板、铜、金盐等核心主材及配套辅材的价格增速显著加快，当前正处于高位震荡阶 段。

为应对上游原材料成本攀升带来的经营挑战，公司将继续深化并落实一系列精细化 成本管控举措：

(1) 强化单位工段成本动态监控与精准管理，通过构建多维度的成本分析模型，实 现成本要素的精细化拆解与实时优化；

(2) 着力提升材料利用率，通过优化拼板面积设计、改进生产工艺流程等手段，在

保障产品质量的前提下，最大化原材料使用效率；

（3）针对部分产品实施结构性提价策略，在综合评估市场需求、竞争态势及客户接受度的基础上，科学制定调价方案，确保价格调整的合理性与可行性。

通过上述综合措施的协同推进，公司旨在实现人均产值与人均效益的双重提升，有效降低产品单位成本，进而消化并转移上游原材料成本上涨所形成的压力，确保公司经营业绩的稳健性与可持续性。

4. 公司目前最新的产能利用率是多少？今年新增产能规划有哪些？

答：目前整体在85%左右。

基于当前市场景气度回升以及订单需求持续增长的态势，公司正积极推进产能布局的优化与拓展工作。具体而言，公司正全力加快珠海一厂（主要面向汽车、安防、光电产品领域）与珠海二厂（专注于服务器、通讯领域）高多层PCB产能释放进程，以充分满足市场需求；珠海三厂的基础设施建设工程已圆满完成，后续将紧密围绕公司整体战略规划及市场需求动态，适时启动生产运营。同时，加速泰国生产基地的建设步伐，旨在构建更为完善的海外生产网络。此外，公司正着手规划利用江门崇达空置的一块土地新建高密度互连（HDI）工厂，以进一步丰富HDI产能，满足客户订单需求。随着国内外生产基地建设项目的稳步推进与持续优化，以及产能的逐步释放，预计将为公司经营业绩的提升注入强劲动力，产生积极影响。

5、子公司三德冠目前业绩是否好转？

据 PrismaMark 报告显示，尽管当前市场需求呈现回暖态势且库存水平逐步优化，但柔性印刷电路板（FPC）领域仍面临价格下行压力与利润率低迷的双重挑战。在整体电子市场持续复苏的宏观背景下，预计 2025 年 FPC 软板行业产值将实现 3.6% 的温和增长。

因行业部分产能因连续亏损出现关闭的情况，以及当前订单结构改善，FPC 产品价格出现了企稳回升的积极信号，三德冠在 2025 年第三季度开始已成功实现扭亏为盈，经营业绩实质性改善。

6、请问公司 2026 年的主要驱动因素有哪些？

当前，受市场整体景气度回升的推动，公司在手机、服务器及通讯等细分领域的产能与交付周期均面临较大压力。与此同时，面向通讯、服务器领域的高多层板、面向手机领域的高密度互连（HDI）板，以及子公司所生产的集成电路（IC）载板等产品市场价

	格均呈现持续回暖趋势。 展望 2026 年，公司将持续依托在产品品质、成本控制及定价策略等方面的综合竞争优势，并积极推动重点新客户的开发与导入，进一步强化在汽车、服务器、医疗、通讯等高价值领域的订单获取能力。此外，公司将系统加强销售团队的专业能力建设，以有效支撑新投产工厂的产能释放，为整体业绩增长提供坚实保障。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无